

华泰联合证券有限责任公司
关于广州方邦电子股份有限公司
首次公开发行股票部分募投项目结项并使用募集资金
临时补充流动资金的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为广州方邦电子股份有限公司（以下简称“方邦股份”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，关于方邦股份首次公开发行股票部分募投项目结项并使用募集资金临时补充流动资金事项进行了核查，并出具本核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意广州方邦电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1212号），并经上海证券交易所出具《自律监管决定书》（〔2019〕151号），同意广州方邦电子股份有限公司向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股，共计募集资金人民币 1,077,600,000.00 元，扣除与发行有关费用人民币 98,560,377.37 元，实际募集资金净额为人民币 979,039,622.63 元。

上述募集资金已于 2019 年 7 月 18 日全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 7 月 18 日对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了“天健验[2019]7-65 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构华泰联合证券、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、募投项目投入情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目的进展情况如下：

单位：人民币万元

序号	募投项目	计划投资金额	调整后投资金额	累计投入金额	投入进度(%)	项目状态
1	挠性覆铜板生产基地建设项目	55,194.63	31,075.72	29,676.26	95.50	项目第一期已于 2022 年 12 月达到可使用状态；第二期于 2024 年 7 月初达到可使用状态，已实现 32.5 万平方米/月的产能，公司将终止后续产能建设（详情见披露于上海证券交易所的《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的公告》（公告编号：2024-009））。
2	屏蔽膜生产基地建设项目	13,251.28	13,252.28	12,782.55	96.46	项目如期建成，设备如期完成安装调试，并于 2022 年 12 月完成环评验收，达到可使用状态，2023 年 2 月达到量产状态，已结项。
3	研发中心建设项目	20,206.00	20,206.00	10,092.45	49.95	拟结项，具体进展详见下文。
4	补充营运资金项目	9,252.05	9,252.05	9,315.09	100.68	不适用
	合计	97,903.96		61,866.35		

三、本次拟结项的募投项目进展情况、募集资金使用及结余情况

本次结项的募集资金投资项目为“研发中心建设项目”，截至 2025 年 6 月 30 日，主要项目如无胶挠性覆铜板、高频信号传输用柔性基板等项目已实现量产，FCCL 产品持续迭代提升；可剥离的极薄电解铜箔项目（带载体可剥离超薄铜箔）已通过相关下游及终端测试认证，持续获得小批量订单，后续订单上量进度有望加快。其他项目如液晶聚合物基板、导电胶膜、自由接地膜等项目因市场空间较为有限、客户需求发生变化等原因，公司根据实际情况减少了资金投入。综上，本项目已达到可使用状态，较好促进了公司屏蔽膜、挠性覆铜板、超薄铜箔等产品的开发及迭代，增强了公司研发创新实力，达到了项目设计目的，现拟

进行结项。

本次结项募集资金投资项目具体使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金拟投资总额(A)	累计已实际支付募集资金金额(B)	已签订合同待支付金额(C)	利息及理财收入扣除手续费后净额(D)	募集资金预计剩余金额(E=A-B-C+D)
研发中心建设项目	20,206.00	10,092.45	5.75	2,594.97	12,702.77

注：1、最终募集资金预计剩余金额以项目结项当日金额为准；

2、已签订合同待支付金额是公司根据已经签署的有关合同和协议将在后续进行支付的款项。

四、本次结项项目募集资金结余的主要原因及后续使用计划

(一) “研发中心建设项目” 募集资金结余的主要原因

1、在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持合理、有效、谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出；同时，本项目的导电胶膜、自由接地膜等部分研发方向因市场空间较为有限、客户需求发生变化等原因，公司未继续追加资金投入；再者，本项目原计划购置的超高频溅射机、高温精密涂布机以及金属激光烧结系统为国外设备，价格较高，近年来在国家提倡科技自主可控及国内相关设备制造行业技术水平不断提升的大背景下，公司通过自研设备和采购国内设备的方式予以解决。以上措施均一定程度降低了本项目资金支出。

2、公司在确保不影响募投项目和募集资金安全的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了一定收益。

(二) 结余募集资金后续使用计划

“研发中心建设项目”结项后，结余募集资金将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照监管部门、公司相关管理规定做好募集资金管理。

后续公司将积极挖掘具有较强盈利能力、未来发展前景较好且能够增强公司核心竞争力的项目，待审慎研究讨论确定后，将严格按照相关法律法规的规定，履行相应的审议和披露程序后实施新项目投资。

在实施新项目投资之前，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同时更好的满足公司运营发展的资金需求，公司拟将使用该部分结余募集资金不超过 12,000 万元临时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还募集资金专用账户。

五、审议程序

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目之“研发中心建设项目”结项，并使用本项目结余募集资金不超过 12,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还募集资金专用账户。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次将首次公开发行股票募投项目之“研发中心建设项目”结项并使用募集资金临时补充公司流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，自公司股东大会审议通过后方可实施。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广州方邦电子股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并使用募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人(签名):

袁琳翕

袁琳翕

张冠峰

张冠峰

